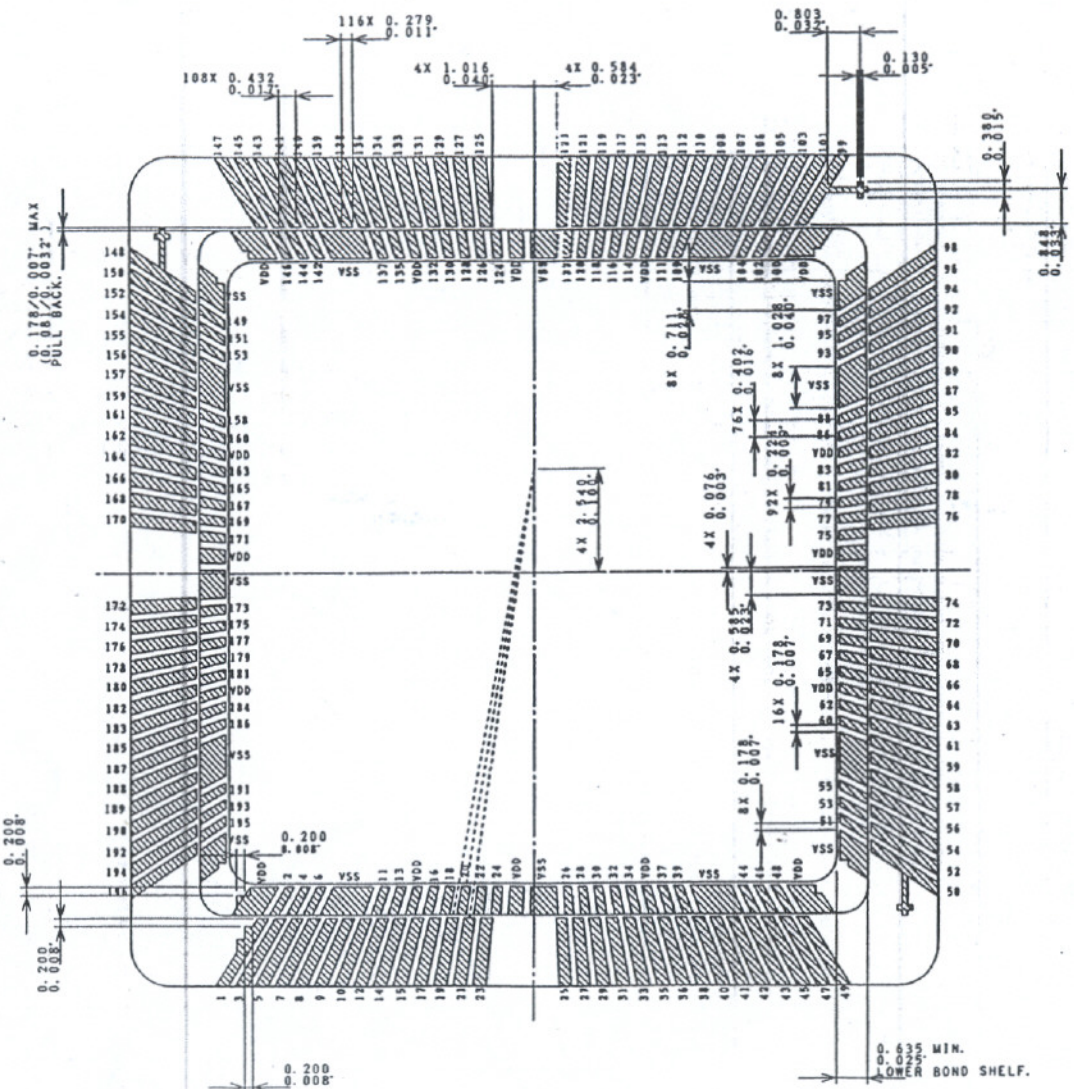


DETAIL OF INDEX MARK.

6	FEB.21.91	K.Kondo	K.Kondo	CHANGED C/C PAD DIM. TOLERANCE AND ADDED NOTE#89	
5	AUG.28.90	K.KONDO	PLKOBAYASHI	CORRECTED LAY UP	
4	NOV.2.89	K.KONDO	PLKOBAYASHI	CHANGED STUD LENGTH	
3	SEP.29.89	K.KONDO	PLKOBAYASHI	CORRECTED STUD DIAMETER	
2	SEP.21.89	K.KONDO	PLKOBAYASHI	CHANGED TYPE OF STUD	
CUSTOMER DWG NO.					
REV.	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPR'D	DESCRIPTION
				APPR'D	TITLE
	AUG.23.89	K.KONDO	M.KASAT	PLKOBAYASHI	PGA223-842
NOTE	SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD.				PROJ. 3RD ANGLE
VLSI.T	SCALE 2:1			DRAWING NO.	REV. 6



NOTES

1. DIMENSION : MILLIMETER/INCH.
2. ALL TOL. : ± 0.13 MM(0.005INCH) UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
3. CERAMIC : DARK OPAQUE(AI O 90%MIN.)
4. CONDUCTOR MATERIAL : TUNGSTEN
5. PLATING
 NI PLATED 1.0 μ m(40 μ INCH) THICKNESS
 +Co PLATED 2.0 μ m(80 μ INCH) (Co:99.0% MIN.)
 +GOLD PLATED 1.5 μ m(60 μ INCH)MIN.
6. D/A SHALL BE FLAT WITHIN 0.05MM(0.002INCH).
7. S/R SHALL BE FLAT WITHIN 0.08MM(0.003INCH).
8. FLATNESS OF PACKAGE OVERALL : .005"/INCH MAX.
9. STUD PERPENDICULARITY : ± 2.0 DEGREE.

注

1. 寸法 : MM / INCH.
2. 指示なき寸法公差は ± 0.13 MM とする
3. 着色セラミックとする。(AL₂O₃ 90%)
4. 導体 : タングステン
5. 表面処理 : Niメッキ(1.0 μ mNOM.)+Coメッキ(99.0%, 2.0 μ mNOM.)+全体Auメッキ(1.5~5.5 μ m)
6. D/Aのソリは, 0.05MM MAX. とする
7. S/Rのソリは, 0.08MM MAX. とする
8. セラミックの全体ソリ : 50 μ m/cm MAX.
9. スタッフの垂直度 : $\pm 2.0^{\circ}$.

CUSTOMER Dwg NO.	REV.		DATE		DESIGNED		APPR'D		DESCRIPTION			
	DATA	DESIGNED	CHECKED	APPR'D	TITLE							
	AUG 23.89	K.KONDO	M.KASAI	M.KOBAYASHI	PGA223-842							
NOTE	SHINKO			PROJ. ANGLE	SCALE	DRAWING NO.	REV.					
	ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD.			8:1		6						

